

ESD-ACF/PI Series

OLB Bonding Cushion Sheet

Technical Data

Product Description

OLB(Out Lead Bonding) 공정에 적용되는 ACF Bonding 압착시트이다.
 열전도율이 우수하며, 이형성, 내열성이 매우 우수하다
 기존의 테프론 시트는 일회성으로 사용하였으나 본 제품은 다회성이 가능한 복합시트이다.

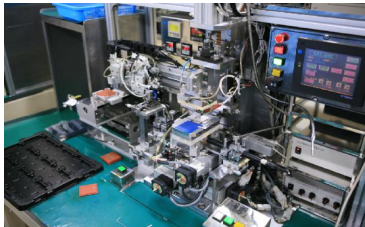
Construction



Complex Silicone layer
Flame Resistance Polyimide film

Features

1. Thermal conductivity : 1.0W/mK
2. Release characteristics
3. Heat resistance : 380°C



Application

- LCD, LED, PDP TV industry
- Mobile part
- Heat transfer sheet
- Heat resistance release sheet

Physical Property

Properties		
열전도도	W/mK	1.0W/mK
체적저항	Ωcm	10^{13}
압착 균일도	Pressure sensitive paper	good
사용가능횟수	Number	>30
비 중	-	1.6
제품 두께	mm	0.05~0.3